

## mAgic DA295A

### 無加圧焼結ペースト

mAgic 焼結ペーストDA295A は、作業性と性能を向上させた鉛フリーのダイアタッチソリューションで、半導体パッケージングにおける厳しい要求に応えます。

#### mAgic DA295A の利点

- 鉛フリー、ゼロハロゲン
- 安定した粘度特性
- 優れたディスペンス性能
- 最大オープンタイム120分
- 金 (Au) 表面で安定した接着力を発揮
- 低温処理 (200°C 以上)
- ボイドフリー
- 洗浄が不要

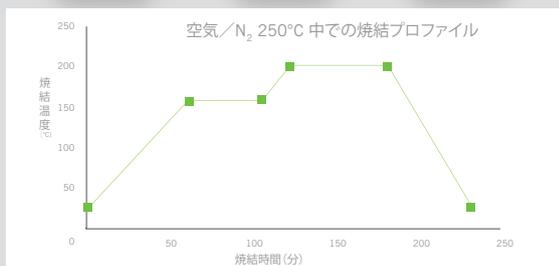


#### アプリケーション情報

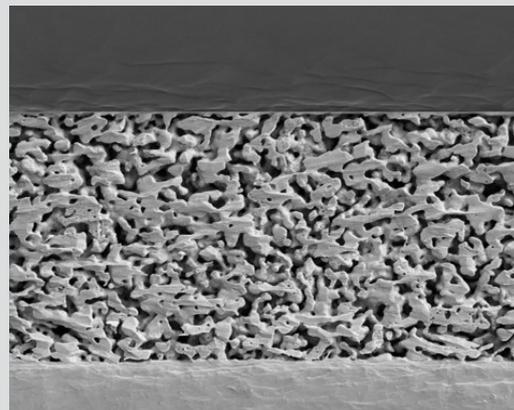
ディスペンス

ダイアタッチ

無加圧焼結



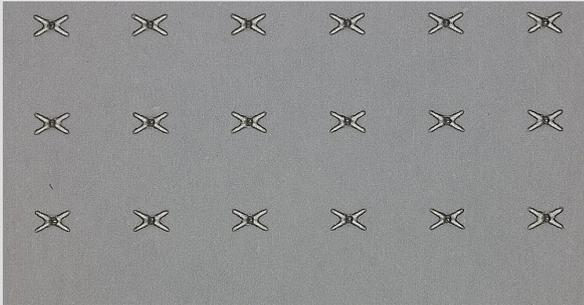
アプリケーション毎の要求事項に応じ、プロセスパラメータを調整してご使用ください



#### 主なダイアタッチ材の比較

材料特性	導電性接着剤	はんだペースト (PbSn5Ag2.5)	mAgic 焼結ペースト DA295A
プロセス温度(°C)	175 ~ 200	360 - 390	≥ 200
Ag含有量(%)	75 ~ 85	2.5	100 (焼結後)
電気伝導率(mΩ・cm)	≤ 0.1	0.046	≤ 0.008
熱伝導率(W/m・K)	3 - 10	44	≥ 100
残渣フリー	○	×	○
鉛フリー	○	×	○

## ディスペンス性の経時変化



最大12時間まで安定したディスペンスが可能(パターンの欠落や不規則パターンがない)



パターン欠落や不規則パターンは検出されませんでした

## 製品特性

物理的特性	DA295A
フィラー	銀
金属含有量	82%
粒径	≤ 25 μm
焼結温度	≥ 200°C
ハロゲン含有量	ゼロハロゲン
対応可能な被着体表面	Ag, Au
焼結雰囲気	Air, N <sub>2</sub>
アプリケーション/プロセス	
	ディスペンス
特徴と利点	
可使用時間	12 時間
棚寿命	6 カ月
残渣の洗浄	不要
保管条件	2 - 10°C

オープンタイム	0 時間	1 時間	2 時間
ボイド性能			
高解像度拡大画像			

**アメリカ**  
電話+1 610 825 6050  
electronics.americas@heraeus.com

**アジア太平洋**  
電話 +65 6571 7649  
electronics.apac@heraeus.com

**中国**  
電話 +86 53 5815 9601  
electronics.china@heraeus.com

**欧州、中東およびアフリカ**  
電話 +49 6181 35 4370  
electronics.emea@heraeus.com

ここに記載された説明および工学データは、ヘレウスが最新の試験装置と一般に認められた手順を用いて編集したものであり、弊社の所有する最新の知識に従って編集されています。ここには、この文書が印刷された時点における最新の情報が記載されています(ご要望に応じていつでも最新版を提供することができます)。データは正確であると考えられますが、弊社はデータの正確さを保証することはできません。また、データの使用によってもたらされる結果、データの使用によって生じる特許侵害についても、弊社は一切の保証を行いません(ただし、このことが契約により事前に明確に合意されている場合はその限りではありません)。データは、ユーザーが特定の用途に対する材料の適合性を試験することを条件として提供されています。Heraeus のロゴ、Heraeus、および mAgic の図形マークは、Heraeus Holding GmbH またはその関連会社の商標もしくは登録商標です。無断複写転載を禁じます。